

熱硬化性樹脂の基礎と応用

～マイクロエレクトロニクス／パワーエレクトロニクス／耐熱性樹脂～

- ◆日時：2025年04月28日（月）10:30～16:30
- ◆会場：【WEB限定セミナー】※在宅、会社にながらセミナーを受けられます
- ◆聴講料：1名につき55,000円（税込、資料付）

※会員登録（無料）をしていただいた方には下記の割引・特典を適用します。
 ・1名でお申し込みされた場合、1名につき**49,500円（税込）**
 ・2名同時でお申し込みされた場合、**2人目は無料（2名で55,000円（税込））**

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

●講師：横浜国立大学 非常勤教員 工学博士 高橋 昭雄 氏

高分子における熱硬化性樹脂の位置付けを明確にすると共に、その基礎、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、シアネート樹脂、マレイミド樹脂等について詳細に解説、エレクトロニクス材料、構造材料等の応用と必要とされる物性そしてそのアプローチについて講義する。

1. 熱硬化性樹脂の基礎

- 1.1 高分子としての熱硬化性樹脂（熱可塑性樹脂との違い）
- 1.2 熱硬化性樹脂の種類と特徴

2. 硬化反応と硬化物物性

- 2.1 硬化反応とその評価、解析
- 2.2 樹脂硬化物の物性評価と解析
機械物性、熱的特性、電気的特性

3. フェノール樹脂とその特徴

- 3.1 レゾールとノボラック
- 3.2 ベンゾオキサジン樹脂

4. エポキシ樹脂とその特徴

- 4.1 脂環式エポキシ樹脂
- 4.2 ビスフェノールA型及びノボラック型エポキシ樹脂
- 4.3 多環芳香族型エポキシ樹脂
- 4.4 複素環型エポキシ樹脂

5. シアネートエステル樹脂とその特徴

6. 付加型ポリイミド樹脂

7. 耐熱性樹脂の新しい展開と応用

- 7.1 エポキシ変性ベンゾオキサジン樹脂
- 7.2 エポキシ変性シアネートエステル樹脂
- 7.3 フェノール変性ビスマレイミド樹脂

8. マイクロエレクトロニクスとパワーエレクトロニクス用樹脂材料

- 8.1 低誘電率、低誘電正接樹脂へのアプローチ
- 8.2 無色透明化へのアプローチ
- 8.3 低熱膨張率化へのアプローチ
- 8.4 高熱伝導率化へのアプローチ
- 8.5 パワーエレクトロニクスと熱硬化性樹脂

9. 構造材料としての熱硬化性樹脂の強靱化

『熱硬化性樹脂【WEBセミナー】』セミナー申込書

会社・大学			
住所	〒		
電話番号		FAX	

お名前	所属・役職	E-Mail
①		
②		

会員登録（無料） ※案内方法を選択してください。複数選択可。

Eメール 郵送

● Webセミナーの受講申込みについて ●

必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下さい。弊社で確認後、必ず受領のご連絡をいたしまして、別途視聴用のURLをメールにお送りいたします。

セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりませんので、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

お申込み・振込に関する詳細はHPをご覧ください。
 ⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>

個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。
 ⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>